斯达半导体股份有限公司
关于变更公司注册资本、修订《公司章程》
并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

斯达半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 04 月 25 日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，鉴于公司因 2023 年度利润分配及资本公积转增股本、2021 年股票期权激励计划行权，股份总数由 170,955,274 股变更为 239,469,014 股，注册资本由人民币 170,955,274 元增加至 239,469,014 元，本议案尚需提请公司股东大会予以审议根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等规定，拟将《公司章程》有关条款进行如下修订，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。具体情况如下：

一、关于变更公司注册资本的基本情况：

公司 2023 年 06 月 09 日分别召开第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第二十四次会议，审议并通过了《关于公司 2021 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件达成的议案》。2021 年股票期权激励计划第二个行权期自 2023 年 07 月 17 日起实际可行权。2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日，累计行权数量为 25,366 股。

公司 2024 年 06 月 03 日分别召开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议，审议并通过了《关于公司 2021 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件达成的议案》。2021 年股票期权激励计划第三个行权期自 2024 年 06 月 21 日起实际可行权。截至 2024 年 12 月 31 日，累计行权数量为 96,118 股。

公司分别于 2024 年 04 月 07 日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议和 2024 年 04 月 29 日召开 2023 年年度股东大会, 审议并通过了《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》, 同意公司以实施权益分派的股权登记日总股本为基数分配利润并以资本公积每股转增 0.4 股, 公司总股本增加 68,392,256 股。

综上所述, 公司股份总数由 170,955,274 股变更为 239,469,014 股。注册资本由人民币 170,955,274 元增加至 239,469,014 元。

二、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的基本情况:

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等规定, 结合上述注册资本的变更情况、进一步保护中小投资者权益, 拟将《公司章程》有关条款进行如下修订, 并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记、章程备案等相关事宜:

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币 170,955,274 元。	第六条 公司注册资本为人民币 239,469,014 元。
2	第二十条 公司股份总数为 170,955,274 股, 均为普通股。	第二十条 公司股份总数为 239,469,014 股, 均为普通股。

除上述条款修订外, 原《公司章程》中的其他内容未作变动。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

斯达半导体股份有限公司董事会

2025 年 04 月 25 日